

Firma LPKF zwiększa moce produkcyjne dla systemów laserowych



Garbsen, 15 luty 2010 – firma LPKF Laser & Electronics AG zdecydowała się na podwojenie mocy produkcyjnych systemów laserowych przeznaczonych do cięcia i wykonywania struktury pcb w Garbsen/Niemcy. Z oświadczenia wynika, że wykonanie tego zadania jest planowane przed końcem pierwszego kwartału, a w drugim kwartale ma nastąpić kolejny etap rozwoju tych działów.

Wszystko czynione jest po to, aby zaspokoić niesłabnący popyt na systemy laserowe do produkcji elektroniki w Azji. W szczególności technologia LDS (Laser Direct Structuring – laserowe, bezpośrednie wykonywanie struktury), która jest obecnie stosowana głównie do produkcji anten komórkowych, zajmuje pierwszą pozycję w firmowym portfelu zamówień od początku ostatniego roku.



“Zwiększyliśmy potencjał wytwórczy w dziale tnących laserów do wykonywania struktury pcb na skutek przeprowadzenia wewnętrznej restrukturyzacji i celowego zatrudnienia. Następne kilka lat przyniesie duży rozwój siedziby w Garbsen. Musimy się dostosować do wzrastającego popytu na nasze systemy laserowe.” – powiedział Ingo Bretthauer, CEO.



Przykład detalu wykorzystującego technologię LDS.

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



spezial electronic

SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl